TSD 深圳市通盛达电子有限公司

TongShengDa Industrial(Shenzhen) Co., Ltd.

承 認 書

APPROVEMENT

客戶	名稱(cu	stomer):								
客戶料號(customer part no):										
規格型號(product name): <u>FPC0.5PH 2.0H 抽屉式上接全包系列</u>										
我司	料號(pa	rt no):_								
客戶	簽核處(custome	er):							
	核准(appd)		工程(eng)		品保(QA)		采购(stock)			
我司	我司簽核處:									
		核准(a	ıppd)	審核(check)	製作	(done)			

肖剑

地址:广东省深圳市宝安区39区3号厂房77栋2楼

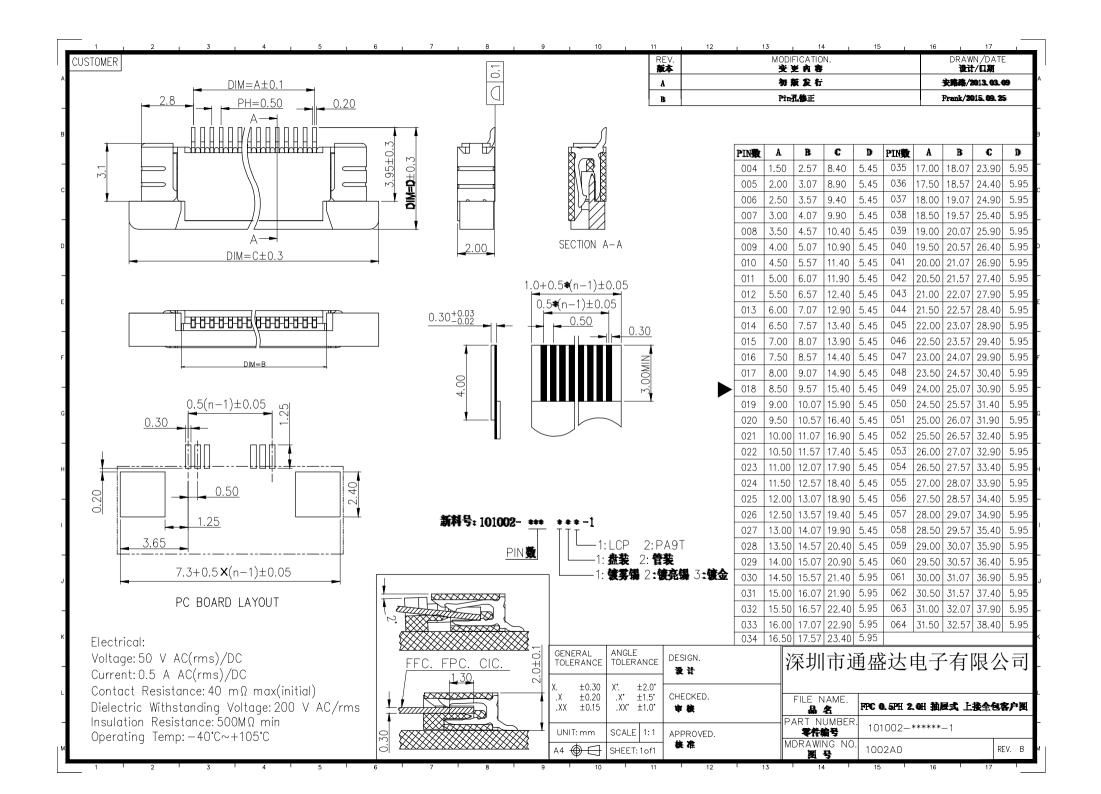
1

目 录

- 1、對面
- 2、 目录
- 3、 产品变更履历表
- 4、 产品工程图面
- 5、 包装规范
- 6、 产品规格书
- 7、 产品 QC 工程图
- 8、 材质证明与物性表

产品变更履历表

版本	日期	制定/修改/废止内容	制定	核准	
A1	2015. 09. 28	新版制订	ANLAN	黄志明	



1. SCOPE[适用范围]

(本规范适用于 FPC0.5PH 2.0H 抽屉式上接全包系列产品.)

2. CONNECTOR DIMEMSOINS SEE ATTACTHED DRAWGING

(外观尺寸请参照图面)

3. MATERIALS(材料):

- A. Housing (主体): Thermoplastic Without Halogen, UL94V-0, Color: Nature;
- B. Cover (后盖): Thermoplastic Without Halogen, UL94V-0,Color: Black;
- C. Contact (端子): Copper Alloy, Gold or Tin plating over Nickel under plating Overall.
- D. Peg (焊片): Copper Alloy, Tin Plating over Nickel under plating overall.

4. RATINGS[额定标准值]

Item[项目]	Standard[规格]				
Operating Voltage(最大容许电压)	50VAC				
Current Rating(最大容许电流)	0.5ADC				
Operating Temperature(使用温度范围)	-25℃~+85℃(包括产品电流通过所产生的温度) -25℃~+85℃(Including Terminal Temperature Rise)				

5. TEST CONDITION[实验条件]

The test and measurement, unless otherwise specified, shall be carryout at a temperature of 15 to 35°C, Relative humidity of 25 to 85%,and atmospheric pressure of 86 to 106KPa. However, when any doubt arises on the judgment value under it, the test and measurement shall be carry out at a temperature of 20 ± 2 °C, relative humidity of 60 to 70%, and atmospheric pressure of 86 to 106KPa.

[除特殊说明之外,一般试验及测试将于温度 15 ~ 35℃,相对湿度 25~85%,大气压力 86~106 KPa 之条件下完成,但若于上述条件下有任何影响判定值的疑虑,可考虑在温度 20±2℃,相对湿度 60~70%及大气压力 86~106 KPa 之条件下完成试验。]

A		NEW REVISION		ANLAN	2014/04/28
REV.	ECN.NO.	REVISION	APPROVED	DRAMN	DATE

Test Requirements and Procedures Summary测试要求和程序摘要。

	Item(项目)	TEST CONDITION (测试条件)	Procedure(规格)			
1	Examination of Product (产品检验)	Visual inspection. (外观检验)	Meets requirements of Product drawing, NO Breakdown 符合图面要求,目视外观无任何损坏异状			
		Electrical Requirement (电标	〔特性〕			
2	Contact Resistance (接触阻抗)	Mate applicable FPC and measure by dry circuit 20mV Max,10mA (将样品与 FPC 连接,测试电压 20mV,限电流 10mA 进行阻抗测试)	30m Ohm Max (30m Ohm 最大)			
3	Dielectric withstanding Voltage (耐电压)	[500]VAC for 1 minute Test between adjacent circuits of unmated connector.(将样品与FPC连接,相邻端子间可以承受 500VAC 1 分钟)	NO Breakdown (目视外观无任何损坏异状)			
4	[500]VAC for 1 minute Insulation Resistance (绝缘阻抗) 证据		500 M Ohm Min. (500M Ohm 最小)			
		MECHANICAL CHARACTERISTICS	(机械特性)			
5	Contact/Peg Retention Force (保持力)	Apply axial pull out force at the rate of [25.4±3]mm/min on the terminal assembled in the housing. (端子与PEG插进主体水平方向拔出力量)				
6	FPC/FFC Retention Force (FPC/FFC保持力)	0.030kgf/Pin Min.(PIN>=13) 0.040kgf/Pin Min.(PIN<13) (片数大于等于13PIN时FFC/FPC每PIN保持力 0.030kg 以上,片数小于 13PIN时FFC/FPC每PIN保持力0.040kg以上.)	Operation Speed:[25.4±3] mm/min Measure the force required to unmated connector. (将盖子盖上,与 FPC 连接后以操作速度每分 钟 25.4±3mm 进行 FPC 保持力测试。)			

7	Durability (耐久性)	Operation Speed: (10) cycle-max./min Durability Cycles: 20 Cycles 操作速度: 10次最大每分钟 耐久次数: 20次	Contact Resistance: 50m Ohm Max 接触阻抗: 50m Ohm 最大			
		Amplitude: 1.52m; Frequency;	Appearance (外观)	No damage (不可破坏)		
8	Vibration (振动试验)	10~55~10HZ; Vibration time:2 hours for 3 axis total 6 hours. (振幅:1.52mm:振动频率:10~55~10HZ;	Contact Resistance (接触阻抗)	50m0hm Max (50m0hm 最大)		
		振动时间: X、Y、Z 轴各 2 小时)	Discontinuity (断电时间)	1u sec. Max.		
		The connectors shall be soldered on the P.C. board. /Acceleration: 50G.	Appearance (外观)	No damage (不可破坏)		
9	Mechanical Shock (冲击试验)	Time: 11ms.(half sine wave). Cycle: 3 cycle for 3 axis total 9 cycle. (FPC 焊接于 PC 板上,/加速度: 50G.) (冲击作用时间: 11ms.)	Contact Resistance (接触阻抗)	50mOhm 最大		
		[冲击次数: X、Y、Z轴各3次(共9次)] {JIS C0041/MIL-STD-202Method213}	Discontinuity (断电时间)	1u sec. Max.		
10	Temperature Rising (温升)	Mate applicable FPC and measure the temperature rise of contact when the maximum AC mated current is. (量测通过 FPC 最大容许电流时,样品接触之温升)	Temperature Rising (温升)	30℃ Max 30℃ 以下		
11	Solder ability <mark>(焊锡性</mark>)	Tip of Solder tails and fitting nails into the molten solder(held at 245 ±5℃) up to 0.1mm from the bottom of the housing for 3±0.5sec	Solder wetting (湿润性)	95% of immersed area must show no voids, Pinholes (焊接覆盖面积必须有95%以上,不得有漏焊现象)		
12	Resistance to Reflow Soldering Heat (回焊高温测试)	Pre Heat:150~180°C,90±30sec. Heat: 230°C Min.,30±10sec Peak Temp.:260+0/-5°C, 10sec. Or less Duration: 2 cycles Refer to Fig.4	Appearance (外观)	No damage (不可破坏)		

13	Thermal Shock	Temperature range form −55°C to +85°C .Start from −55°C,after 30 min. Change to +85;°Cchang time is no more than 30 seconds. Total 5	Appearance (外观)	No damage (不可破坏)
13	(热冲击试验)	cycles. 温度变化范围: -55℃~+85℃; 从-55℃开始, 30分钟换到+85℃: 转换时间不超过 30 秒: 共 5 个循环。 {MIL-STD-202, 方法 107D,条件 A}	Contact Resistance (接触阻抗)	50 m Ohm 最大
		40 ± 2 ℃ in temperature and 90~95%RH for 96 hours. After testing connector shall be left	Appearance (外观)	No damage (不可破坏)
14	Humidity—Temp erature Cycle (耐湿性试验)	alone for 1 to 2 hours in a room ambient. [温度 40±2℃,相对湿度 90~95%,持续 96 小 时。经试验后,连接器须于室温中放置 1~2	Contact Resistance (接触阻抗)	50 m Ohm 最大
		小时,再测定其值。] {EIA-364-31A, Method II, condition A}	Insulation Resistance (绝缘阻抗)	500 m Ohm Min
15	Temperature Life (恒温恒室试验)	Mated, Connector 85℃, 250 hours,	Contact Resistance (接触阻抗)	50 m Ohm 最大
	Salt Spray (盐水喷雾试验) (造水喷雾试验)	Salt concentration: 5%/ Temperature: 35±2℃,Testing time: 24±2 hours, After salt is removed by running water and a dropis	Appearance (外观)	No damage (不可破坏)
16		removed, it is measured. (盐水比重: 5% / 温度: 35±2℃) (试验时间: 24±2 小时,用清水将残留盐份清洗 并将水滴清除后,才可测量。) {EIA-364-26A, Condition A}	Contact Resistance (接触阻抗)	50 m Ohm 最大

Figure 1 (End)

6.CONNNECTOR TESTS AND SEQUENCES (测试顺序)

	Test Group									
Test or Examination	А	В	С	D	Е	F	G	Н	Ι	J
		Test Sequence (a)								
Examination of Product (产品检验)	1, 7	1, 9	1,6	1, 5	1, 5	1, 5	1,5	1, 3	1, 3	1, 3
Contact Resistance(<mark>接触阻抗</mark>)		2,8	2, 5	2, 4	2, 4	2, 4	2, 4			
Dielectric withstanding Voltage (耐电压)	3, 6									
Insulation Resistance (<mark>绝缘阻抗</mark>)	2, 5									
Contact/ Peg Retention Force (保持力)		3, 7								
FPC/FFC Retention Force (FFC/FPC 保持力)		4,6								
Durability (耐久性)		5								
Vibration (振动试验)			3							
Mechanical Shock (冲击试验)			4							
Temperature Rising (温升)								2		
Solder ability (<mark>焊锡性</mark>)										2
Resistance to Soldering Heat (回焊高温测试)									2	
Thermal Shock(热冲击试验)				3						
Humidity Temperature Cycling (耐湿性试验)	4				3					
Temperature Life (恒温恒室试验)						3				
Salt Spray(盐水喷雾试验)							3			

Figure 2

Figure 3. Contact Resistance

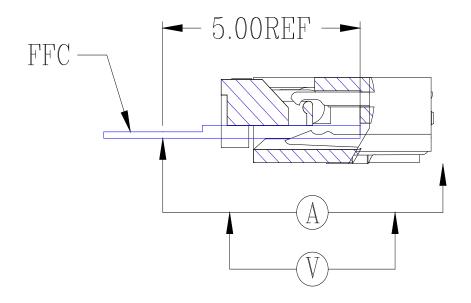
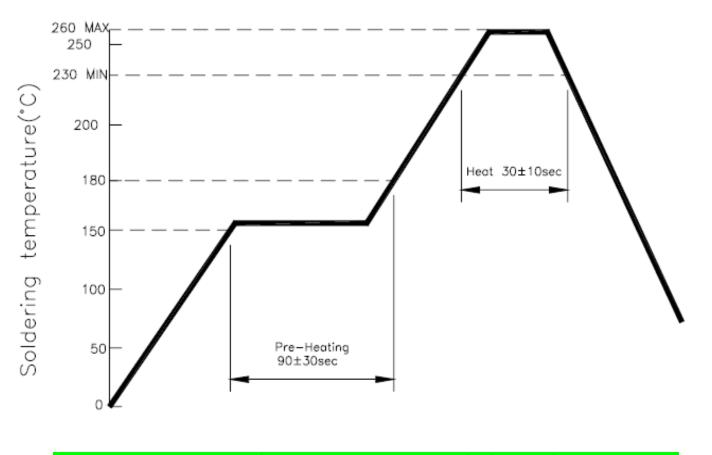


FIGURE 4. RESISTANCE TO FLOW SOLDER HEAT



0. FPC0. 5PH 2. 0H 抽屉式产品过程控制流程图 生产 储存 搬运 检验 序号 过程描述 地点 设备 等级 产品特殊特性 等级 过程特殊特性 "\phi" "O" $^{\prime\prime}\Delta^{\prime\prime}$ ″ 🗆 ″ 规格型号 显微镜/卡尺/钢 进料检验 IQC 胶料/铜材性能 1 外观状态/包装状态 材料入/出 仓库 材料储存 材料入库/搬运 2 \triangle 产品重点尺寸 设备保养 冲压端子/ 冲压机/显微镜/ 3 冲压车间 \Diamond 端子GAP 端子GAP制程能力 \blacktriangle 焊片 卡尺/立式投影仪 外观/预断口状态/料带弯曲 产品尺寸 设备保养 注塑机/显微镜/ 外观状态 成型条件管控 成型胶芯/ \triangle 4 \Diamond 成型车间 卡尺/工具显微镜 后盖 胶芯Pin孔尺寸 胶芯Pin孔制程能力 /卧式投影仪 后盖转轴尺寸 转轴尺寸制程能力 委外电镀 材料出库/搬运 5 \bigcirc 仓库 材料发放 端子/焊片 电镀规格/外观状态 电镀层附着性/防腐性 盐雾测试机/卡尺 电镀检验 电镀层粘锡性/耐热性 6 IQC /烤箱/显微镜/锡 炉/回流焊 电镀膜厚 \triangle 包装状态 材料入/出 仓库 材料储存 材料入库/搬运 7 \triangle 库 排插机/显微镜/ 0K投产 组装车间 端子插入尺寸 \Diamond 胶芯插PIN 设备保养 8 \triangle 工具显微镜 9 初检 组装车间 放大镜 外观状态 10 装焊片 组装车间 治具 △ 焊片插入尺寸 $\Diamond \blacktriangleleft$ 组装车间 治具 外观状态 装后盖 11 **◇**-端子插入尺寸 平面度制程能力 显微镜/工具显微 外观状态 接点直线度制程能力 镜/拉力计/电性 12 **→** □ 首件 **IPQC** 端子保持力/FFC线保持力 设备保养 测试机/烤箱/回 耐焊热性/电性/沾锡性 焊炉/锡炉 端子焊脚平面度/接点直线度 \Diamond 组装车间 治具 外观状态 13 折料/入管 外观状态检验 14 外观全检 组装车间 Picth状态/接点状态检验 ▲ 焊接平面度全检 平面度检 测试位置点检管理 组装车间自动检测机 15 验 接触点平整度全检 设备保养 外观状态 平面度制程能力 拉力计//回焊炉/ 端子保持力/FFC线保持力 接点直线度制程能力 16 终检 FQC 锡炉 耐焊热性/电性/沾锡性 设备保养 端子焊脚平面度/接点直线度 组装车间 包装机 包装要求 设备保养 17 \Diamond 包装 \wedge 外观状态 包装检验 包装要求 18 FQC 剥离力测试机 △ 上盖带剥离力 设备保养 成品入库 组装车间 成品储存 成品入库/搬运 19 \triangle 规格尺寸 20 出货检验 0QC 端子保持力/FFC保持力 耐焊热性/电性/沾锡性 仓库 成品发放 成品出库/搬运 21 \bigcirc 成品出货